

Pôle de compétitivité



Le Pôle de compétitivité MAUD et l'ESIEC Reims (École Supérieure d'Ingénieurs en Emballage et Conditionnement) s'engagent dans un partenariat stratégique pour la filière économique Packaging - Emballage

Villeneuve d'Ascq – 23 septembre 2008 : Olivier VARLET, Directeur Général, Pôle de Compétitivité MAUD, et Marc MONTEIL, Président du Conseil d'Administration de l'ESIEC Reims, ont signé ce jour un accord de partenariat marquant leur souhait de dynamiser la filière économique du « Packaging » au niveau national et international.

Le packaging est l'un des trois marchés clés du Pôle de compétitivité MAUD (Matériaux & Applications pour une Utilisation Durable), pour lequel le Pôle entend mener des actions offensives de stimulation de l'innovation.

Cette collaboration entamée avec l'ESIEC, est un rapprochement naturel d'acteurs impliqués dans une vision stratégique du développement de la filière packaging. Olivier Varlet Précise : « comme tous les Pôles de compétitivité, nous devons atteindre une masse critique en terme d'entreprises impliquées, de recherche et de formation. De cette intelligence collective ainsi créée, nous pourrons puiser les projets d'innovation et les accompagner au plan international ».

L'ESIEC Reims est une École d'ingénieurs reconnue internationalement et en parfaite synergie avec les besoins de compétences des entreprises de la filière packaging. Industriels du secteur, PME-PMI nationales et internationales y trouvent les ressources nécessaires à leur développement.

« C'est une magnifique opportunité », indique Marc Monteil, « Le fruit de cette collaboration avec le Pôle de compétitivité MAUD nous permettra sans aucun doute de formaliser certains projets d'innovation en partenariat avec les entreprises proches de l'École, et accompagner leur développement grâce au savoir-faire du Pôle dans ce domaine. La labellisation de nos projets d'innovation par le Pôle de compétitivité est une garantie de l'excellence que nous souhaitons valoriser et surtout de la réalité économique des résultats de nos projets ».

Le rapprochement transrégional (Nord-Pas de Calais / Champagne-Ardennes) du Pôle de compétitivité MAUD et de l'ESIEC Reims, est également synonyme d'une ouverture entre établissements de formation. Ainsi l'EIPC (École d'ingénieurs du Pas de Calais), déjà partenaire du Pôle, trouvera dans cette collaboration du Pôle avec l'ESIEC les passerelles idéales pour proposer de nouvelles compétences aux entreprises du secteur Packaging.

Le Pôle de compétitivité MAUD poursuit ainsi à travers ce nouveau partenariat sa volonté de développer des accords stratégiques majeurs dans l'objectif de favoriser et d'accompagner des projets d'innovations de premier rang toujours dans le respect de ses valeurs fondatrices : écoute des attentes du marché, mise en réseau des acteurs, partage de compétences et nouveaux modèles de développement.

NB : le secteur économique Packaging – Emballage représente 115 000 salariés en France pour un Chiffre d’Affaires global de 18 milliards d’Euros.

Pôle MAUD

Le Pôle de compétitivité MAUD est l'un des 71 Pôles labellisés par le Gouvernement Français. Centré sur les Matériaux & Applications pour une Utilisation Durable, le Pôle intègre notamment les nouvelles applications de la chimie douce (non issue du pétrole) pour favoriser l'innovation (produits, services, compétitivité) sur trois marchés clés internationaux : Arts de la table, Packaging – Emballage et Imprimerie.

ESIEC Reims

L'ESIEC est une école supérieure, qui forme des Ingénieurs en Emballage et Conditionnement. Réputée au plan international, elle forme depuis 1981 des cadres et ingénieurs très opérationnels qui accompagnent les entreprises dans leurs besoins en Packaging. L'École s'appuie également sur ses laboratoires de recherche pour anticiper les futures applications en entreprise.

Contact Presse :

M. Olivier Varlet, Directeur Général

Mail : olivier.varlet@polemaud.fr
Tel : 03 20 34 54 80
Adresse : Centre Innovation CIEL
Parc Scientifique de la Haute-Borne
5 rue Héloïse
59650 Villeneuve d'Ascq